

21/3 期豊富な受注残とコンプレッション比率向上などで収益大幅回復、22/3 期上伸期待

株価 1166 円 (6/25) 時価総額 292 億円 (6/25) 発行済株 25,021 千株 (6/25)

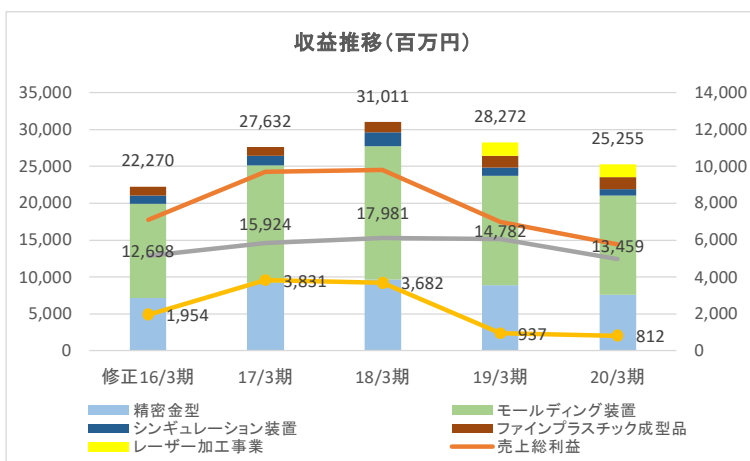
PER (21/3DOI: 21.4X) PBR (1.08X) 配当 16.00 円 配当利回り: 1.37%

要約

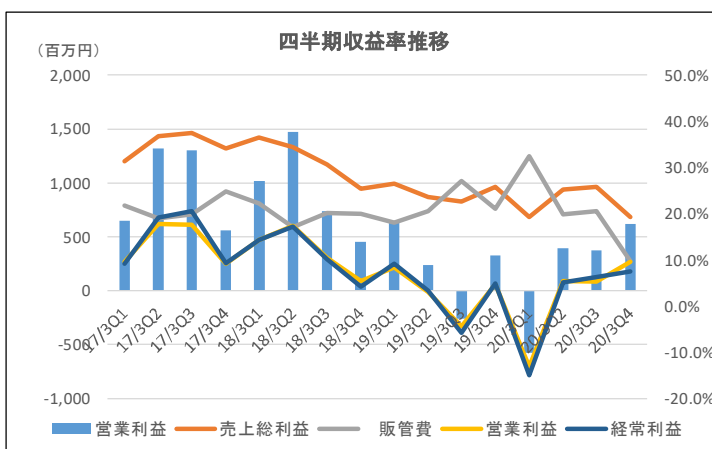
- 20/3 期は 10.7%減収 13.3%営業減益ながら Q4 は 87.5%営利増、受注も 58.6%増に
- 21/3 期は豊富な受注残とコンプレッション比率向上などで 14.8%増収、営利 2.46 倍予想
- 中計を公表、24/3 期に売上高 500 億円、営利 80 億円目指す

20/3 期は 10.7%減収 13.3%営業減益ながら Q4 は 87.5%営利増、受注も 58.6%増に

20/3 期は売上高 252.55 億円 (10.7%減)、営利 8.12 億円 (13.3%減)、経常利益 6.47 億円 (31.1%減)、税引利益 3.68 億円 (58.0%減) と、半導体設備投資の低迷が響いた決算となった。但し、10/29 の減額修正予想に対しては売上高で 4.86 億円未達成だったものの、営利では利益は若干上回って着地した。また Q4 だけを取り出すと、前年同期比 6.9%減収ながら、営利 87.5%増、受注も 58.6%増と急回復している。

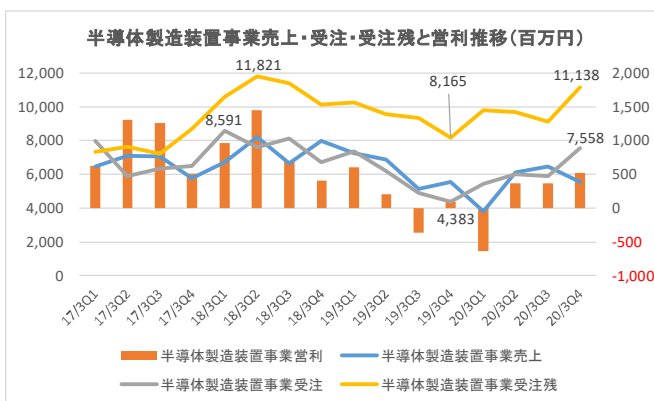


セグメント別で半導体製造装置事業は売上高 219.03 億円 (11.8%減) ながら営利 6.18 億円 (14.3%増)、受注は 248.75 億円 (19.8%減)。売上面では米中摩擦の影響でモールドング装置が期初に大きく落ち込み、期末には



はコロナウイルス影響で設備搬入が遅れたことも影響した。売上の中身では精密金型が売

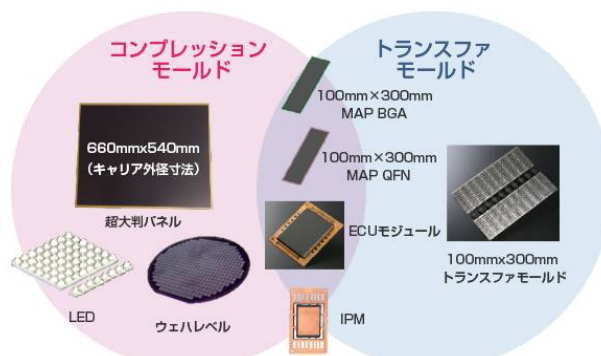
上高 15.6%減、モールド装置 9.0%減、シンギュレーション装置 22.1%減といずれも減収となっている。しかし高採算のコンプレッション装置比率が 31%から 48%と 17 ポイントも向上、受注で 95.3 億円 (67.5%増)、販売はコロナ影響で検収遅れもあり 77 億円 (35%増) 程度の伸びに止まったと見られるが、いずれも大幅増収となり、増益の源泉となっている。Q4 だけでは売上高 55.31 億円 (0.6%減)、営利 5.22 億円 (5.7 倍)、受注高 75.58 億円 (72.4%増)、受注残高 111.38 億円 (36.4%増) と伸長著しい。



その他、ファインプラスチック成形品部門は 0.7%増収、14.3%営利増 (営利 2.42 億円)、オムロンから買収したレーザ加工装置部門は売上高 17.37 億円ながらコロナ影響もあり利益はのれん等負担もあり 0.48 億円の営利損失に。

### 21/3 期は豊富な受注残とコンプレッション比率向上などで 14.8%増収、営利 2.46 倍予想

21/3 期会社予想は売上高 290 億円 (14.8%増)、営業利益 20 億円 (2.46 倍)、経常利益 20 億円 (3.1 倍)、税引利益 13.6 億円 (3.7 倍) 予想としている。なおこの予想は、2/27 に策定した「TOWA グループ 第 3 次中計 (4 カ年) 経営計画」の初年度数値を採用しており、3 月以降のコロナウイルス影響の拡大、マレーシア工場が 5/3 まで一部生産を縮小しているなどの影響は考慮されていない模様。



トランスファ方式とコンプレッション方式によるモールド

現状、豊富な受注残高を持ち、今期の受注環境も Q1 は堅調な出足となっている。実際、6/25 に発表となった SEMI の北米に本拠を置く半導体製造装置メーカーの 5 月売上 (3 ヶ月移動平均) では 4 月比 2.9%増、前年同月比 13.1%増、日本半導体製造装置協会でも 5 月は 4 月比 1.3%減ながら、前年同月比は 16.1%

	フェイスダウン	フェイスアップ
樹脂流動性	○	×
チップシフト	○	△
真空度	○	△
SIP製品	○	×
フィラー分離(反りの要因)	○	△

増と、コロナ影響下でも健闘している。同社の高い利益率を誇るコンプレッションモールド装置は、モールド面積の大型化に対し、均一かつ極薄なモールドが可能で、フェイスアップ方式に比べ、成形時に発生する反りが少なく、モールド後のバックバライディングや CMP(化学機械研磨)工程レスでプロセス全体の時間短縮の優位性がある。従来はメモリデバイスで不可欠な装置であったが、通信モジュール向けにも活用範囲が広がり、コンプレッションモールド装置比率が 50%を超えている。しかも従来の主力製品である PMC1040-D に対し、2018 年 6 月に投入した生産性を向上させた PMC2030-D の販売が本格拡大、総利益率で 50%超を確保できる製品として収益に大きく貢献しよう。更に新モデルの超大型 PLP (パネルレベルパッケージ) 対応機の CPM1180 出荷も業界に先駆け 2019 年 12 月より始め、次世代大型ライン対応に期待がかかる。

加えて新事業分野として注力している TSS 事業 (TOWA 韓国の部品・サービス・装置改造ビジネス) も、20/3 期は半導体設備投資低迷で売上高 43.23 億円 (11.4%減) と一服したが、21/3 期は韓国での半導体設備投資回復もあり 30%超の伸びが期待される。その他事業も、受託加工のツーリングビジネスは小規模ながら売上倍増ペース、レーザ加工装置も緩やかな拡大が見込まれる。



全体として、上期会社計画はコロナ影響がマレーシア工場などで発生していると考えられ、その他でも売上面で影響が出ていると判断、半導体製造装置は前工程の回復が先行、後工程の製造装置回復は多少ずれるとみられ、上期会社予想の売上高 140 億円、営業利益 7.8 億円は未達懸念があるものの、下期は 5G スマホの投入、データセンター向けメモリの拡大、アフタコロナ時代でリモートワーク、リモート教育などで PC 需要も再拡大が見込め、更に年末には SSD 搭載の「プレステ 5」や「X-BOX シリーズ X」のゲーム機投入もあり、21/3 期通期予想については受注拡大と能力増強効果もあり、上期の遅れをカバーし、会社計画並みの収益が期待される。

### 中計を公表、24/3 期に売上高 500 億円、営業利益 80 億円目指す

会社側では 2/27 に中期計画として、24/3 期に売上高 500 億円、営業利益 80 億円目指す計画を公表している。コンプレッション装置の比率向上が更に進む見通しの中で、マレーシア工場では従来の 3 倍にあたる 12000 坪の土地を確保し、2019 年 12 月に完成したが、同工場では CPM1180 の専用ラインも構築、生産拡大を加速させる。またトラ

第 3 次中期 (4 年) 経営計画				
(単位: 億円)				
	2021/3期	2022/3期	2023/3期	2024/3期
売上高	290	350	420	500
営業利益	20	40	60	80
経常利益	20	40	60	80
当期純利益	14	28	42	56

ンスファーモールド装置も、5G スマホの本格拡大で、多眼化、カメラモジュールの薄化ニーズも高まり、改めて受注拡大が期待される。このほか、新事業としてTSS、レーザ発振器や「レーザトリマ」、「ウェハマーカー」などのオムロンから買収したレーザ加工装置、医療用機器（アドスプレー：スプレー式癒着防止材用機器）などの拡大も期待される。

第3次中期（4カ年）経営計画				
	(単位：億円)			
	2021/3期	2022/3期	2023/3期	2024/3期
売上高	290	350	420	500
半導体事業	185	225	263	310
化成品事業	17	18	20	21
新事業	68	84	110	139
レーザ事業	20	23	27	30

全体として半導体需要の拡大に加え、ファンアウトなど最先端パッケージ（5G、データセンター、車載、AI など）向けにコンプレッションモルディング装置の採用が増加しよう。ちなみに世界の FOWLP 市場は、2020 年～2024 年に平均 16%成長し、2024 年には世界で 19 億 4,000 万米ドルの規模に達するとの予測がある。また新規事業も TSS 中心に半導体ソリューションビジネスの拡大が見込まれ、中計計画通りの収益が期待される。

TOWA(6315)	(百万円、円)									
	売上高	増減率	営業利益	増減率	経常利益	増減率	税引利益	増減率	EPS	配当
19/3期	28,272	-8.8%	937	-74.6%	940	-73.4%	878	-71.0%	35.09	10.00
20/3Q1	4,371	-42.6%	-576	赤転	-656	赤転	-498	赤転	-19.92	0.00
20/3Q2	7,271	-5.4%	394	66.9%	372	43.1%	297	-25.8%	11.88	0.00
20/3Q3	7,160	18.5%	377	黒転	442	黒転	280	黒転	11.21	0.00
20/3Q4	6,453	-6.9%	617	87.5%	489	46.4%	290	-13.9%	11.58	16.00
20/3H1	11,642	-23.9%	-182	赤転	-284	赤転	-201	赤転	-8.04	0.00
20/3H2	13,613	4.9%	994	1453.1%	931	黒転	570	黒転	22.79	16.00
20/3期期初会予	30,000	6.1%	1,600	70.8%	1,620	72.4%	1,165	32.7%	46.58	16.00
20/3期修正会予(10/29)	25,741	-9.0%	718	-23.4%	616	-34.5%	438	-50.1%	17.51	16.00
20/3期	25,255	-10.7%	812	-13.3%	647	-31.2%	369	-58.0%	14.75	16.00
21/3H1会予	14,000	20.3%	780	黒転	780	黒転	530	黒転	21.19	0.00
21/3H2会予	15,000	10.2%	1,220	22.7%	1,220	31.0%	830	45.6%	33.19	16.00
21/3期会予	29,000	14.8%	2,000	146.3%	2,000	209.1%	1,360	268.6%	54.38	16.00
22/3期中計会予	35,000	20.7%	4,000	100.0%	4,000	100.0%	2,800	105.9%	111.96	
23/3期中計会予	42,000	20.0%	6,000	50.0%	6,000	50.0%	4,200	50.0%	167.94	
24/3期中計会予	50,000	19.0%	8,000	33.3%	8,000	33.3%	5,600	33.3%	223.92	
21/3H1DO予	13,500	16.0%	650	黒転	650	黒転	440	黒転	17.59	0.00
21/3H2DO予	15,500	13.9%	1,350	35.8%	1,350	45.0%	920	61.4%	36.79	16.00
21/3期DO予	29,000	14.8%	2,000	146.3%	2,000	209.1%	1,360	268.6%	54.38	16.00
22/3H1DO予	16,500	22.2%	1,800	176.9%	1,800	176.9%	1,250	184.1%	49.98	0.00
22/3H2DO予	18,500	19.4%	2,200	63.0%	2,200	70.4%	1,550	68.5%	61.98	33.00
22/3期DO予	35,000	20.7%	4,000	100.0%	4,000	100.0%	2,800	105.9%	111.96	33.00

年度	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期会 予	22/3期中 計会予	23/3期中 計会予	24/3期中 計会予
売上高	27,632	31,011	28,272	25,255	29,000	35,000	42,000	50,000
営業利益	3,831	3,682	937	812	2,000	4,000	6,000	8,000
経常利益	4,132	3,540	940	647	2,000	4,000	6,000	8,000
親株主帰属純利益	3,868	3,027	878	369	1,360	2,800	4,200	5,600
セグメント売上情報年度	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期会 予	22/3期中 計会予	23/3期中 計会予	24/3期中 計会予
半導体事業	22,600	25,280	19,660	17,070	18,500	22,500	26,300	31,000
化成品事業	1,247	1,431	1,602	1,613	1,700	1,800	2,000	2,100
新規事業	3,780	4,300	5,156	4,863	6,800	8,400	11,000	13,900
レーザー事業	0	0	1,844	1,737	2,000	2,300	2,700	3,000
年度	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期会 予	22/3期中 計会予	23/3期中 計会予	24/3期中 計会予
売上高	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
売上原価	65.0%	68.4%	75.3%	77.1%				
売上総利益	35.0%	31.6%	24.7%	22.9%				
販管費	21.2%	19.7%	21.4%	19.7%				
営業利益	13.9%	11.9%	3.3%	3.2%	6.9%	11.4%	14.3%	16.0%
経常利益	15.0%	11.4%	3.3%	2.6%	6.9%	11.4%	14.3%	16.0%
親株主帰属純利益	14.0%	9.8%	3.1%	1.5%	4.7%	8.0%	10.0%	11.2%

